

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2013-026

深圳丹邦科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目

达到预定可使用状态时间的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目基本概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕1373号”文核准，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.00元，募集资金总额为人民币520,000,000.00元，扣除发行费用人民币24,107,300.00元，实际募集资金净额为人民币495,892,700.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了天健验[2011]3-55号验资报告。

二、募集资金投资项目进展情况

公司募集资金投资项目按照公司在首次公开发行并上市时相关文件中所披露的投资进度及建设周期，应于2013年下半年达到预定可使用状态。超募资金投资项目原定于2013年上半年达到预定可使用状态。由于投资及建设进程加快，在2011年年度报告及2012年半年度报告披露时点，公司预计募集资金投资项目及超募资金投资项目达到预定可使用状态的时间将有所提前，分别提前至2012年12月30日及2012年11月30日。由于上述项目中部分生产设备仍处于安装、调试阶段，部分生产人员正在招聘、培训过程中，同时公司尚在办理相关验收手续，因此在2012年年度报告披露时点，公司预计上述项目达到预定可使用状态的时间延后至2013年6月30日。

截至2012年12月31日，变更后的承诺投资项目进度明细表（单位：万元）

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目	42,500.00	42,500.00	42,584.64	100.02%	2013年06月30日
柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目	7,089.27	7,089.27	7,093.51	100.06%	2013年06月30日

三、本次项目调整的原因及具体内容

截止本公告披露之日，公司募集资金投资项目及超募项目进展顺利，但受制于项目的消防验收手续正在进行中，因此上述项目达到预定可使用状态的日期顺延至2013年7月31日。

四、对公司经营的影响

上述项目达到预定可使用状态日期的调整不会对公司经营造成重大影响。

公司将持续有效的推进募集资金项目及超募项目的进展，在完成消防验收后，开始相关认证及试生产等工作，争取使新厂房能尽早投入使用，提升公司整体实力，促进公司快速发展。

五、相关审核及批准程序

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意上述募集资金投资项目及超募项目调整达到可使用状态的时间。

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》。公司监事会对本次募集资金投资项目及超募项目达到预定可使用状态时间进行调整发表如下意见：本次调整该募投项目及超募项目达到可使用状态时间是根据项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意上述项目调整达到可使用状态时间。

公司独立董事发表意见如下：公司根据具体项目进展情况及投资计划，采取审慎的态度适当地调整项目时间，有利于保证项目质量，是符合公司实际情况和全体股东利益的，我们同意公司调整募集资金项目及超募项目达到预定可使用状态时间。

六、保荐机构意见

保荐机构核查了公司董事会会议决议及相关议案。

经核查，保荐机构认为：（1）丹邦科技调整募集资金项目及超募项目达到可使用状态的时间是根据公司实际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

（2）本次募集资金项目及超募项目调整事项已经公司董事会审议通过，独

立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。综上所述，丹邦科技本次调整募集资金项目及超募项目达到预定可使用状态的时间符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构同意丹邦科技本次调整募集资金项目及超募项目达到预定可使用状态的时间。

七、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议；
2. 第二届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事发表的独立意见；
4. 招商证券股份有限公司出具的保荐意见。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2013年7月16日